

平成27年度経済産業省委託「新分野進出支援事業（地域イノベーション創出促進事業（エレクトロニクス、エネルギーシステム産業創出事業（新技術ビジネス化促進事業））」

□平成27年度の主な活動内容

情報提供

◆キックオフフォーラム◆

平成27年度経済産業省委託事業「新分野進出支援事業」の一環である、新技術ビジネス化促進事業のキックオフフォーラムを開催

『日本のものづくりとインダストリー4.0』

日時：平成27年8月18日（火）

メイン会場：京都リサーチパーク サイエンスホール

サテライト会場：京都リサーチパーク AV会議室

出席者：124名

【基調講演】「産業政策としてのインダストリー4.0」（株）野村総合研究所

【講演1】「リチウムイオン二次電池関連産業の現状と次世代二次電池への期待」

中小機構 近畿 チーフアドバイザー[工学博士] 田中 俊秀 氏

【講演2】「パワーエレクトロニクスとSiC半導体の市場動向」（株）産業タイムス社

【取組紹介】NITE[独立行政法人製品評価技術基盤機構]

※フォーラム終了後、別会場にて交流会を開催



◆技術セミナー◆

ポストLiイオン二次電池開発に欠かせない技術の最新動向・先行事例を紹介

『全固体二次電池研究会 技術セミナー』

～Smartな次世代を実現するポストLiイオン二次電池，全固体電池について考える～

日時：平成27年11月16日（月）

場所：京都リサーチパーク イノベーションルーム

出席者：71名

【事業説明】「成長戦略「3つの見える化」～中小・中堅企業 あなたが主役～」 経済産業省 立地環境整備課

【講演1】「無機ガラス系電解質を用いた全固体二次電池の開発と展望」

大阪府立大学大学院 工学研究科 教授 辰巳砂昌弘 氏

【事例紹介1】「積層焼結型セラミックス全固体電池の開発」（株）村田製作所

【事例紹介2】「各種成膜技術・装置のご紹介」（株）SCREENファインテックソリューションズ

【講演2】「電池大型化と耐熱性、安全性向上に向けた材料技術の進展」

国立研究開発法人産業技術総合研究所 関西センター

上席イノベーションコーディネータ 兼 山形大学特任教授 境 哲男 氏

※セミナー終了後、別会場にて交流会を開催

『第1回ポストリチウムイオン二次電池研究会』

～リチウムイオン二次電池の現状と課題とこれから～

日時：平成27年12月9日（水）

場所：京都リサーチパーク サイエンスホール

出席者：85名

【イントロダクション】京都大学大学院工学研究科

教授 安部武志 氏

【講演1】「リチウムイオン電池の最新トピックス(主にビジネス的な側面に関して)」(株)八山

【講演2】「リチウムイオン電池の現状と課題」 福井大学産学官連携本部 特命教授 井上 利弘 氏

【講演3】「電力系統の負荷平準化に貢献する分散型エネルギーマネジメントシステム」(株)村田製作所

【パネルディスカッション】「リチウムイオン二次電池」は今後どうなるのか？」

※研究会終了後、別会場にて交流会を開催



平成27年度経済産業省委託「新分野進出支援事業（地域イノベーション創出促進事業（エレクトロニクス、エネルギーシステム産業創出事業（新技術ビジネス化促進事業））」

『第2回ポストリチウムイオン二次電池研究会 ～次世代蓄電池のための新規技術およびプロセス～』

日時：平成28年2月9日（火）

場所：グランフロント大阪 カンファレンスルームズ

参加者：68名

【講演1】「究極のリチウム二次電池の展望とポストリチウムへの技術」

関西大学 電気化学研究室 教授 石川 正司 氏

【講演2】「リチウムイオン電池の現状と将来」

東北大学未来科学技術共同研究センター 特任教授 白方 雅人 氏

【事例・課題紹介1】「電池分野の事業化に向けての開発ポイント

～新規参入の可能性を中心に～」 (株)KRI

【事例・課題紹介2】「革新型二次電池「全無機全固体電池」のための

要素技術開発」

(地独)大阪市立工業研究所 電子材料研究部 電池材料研究室 室長 兼 研究主幹 高橋 雅也 氏

【事例・課題紹介3】「PHEV（プラグドインハイブリッド車）の開発と電池課題への取り組み」 三菱自動車工業(株)

※研究会終了後、別会場にて交流会を開催



新規プロジェクト創出

◆パワーエレクトロニクス 材料・プロセス・応用研究会◆

パワー半導体やパワーデバイスに係る情報共有型のオープン形式の研究会を全3回開催。

講演後に講師、参加者同士の交流の場として名刺交換会を各回実施。

経済産業省 近畿経済産業局／京都府中小企業技術センター／京都リサーチパーク株式会社の共催。

『第1回 テーマ「材料」』

日時：平成27年9月18日（金）

場所：京都府中小企業技術センター 5階 研修室

出席者：41名

【講演1】「エレクトロニクス実装のためのめっき技術の基礎・現状・課題」

(地独)大阪市立工業研究所 藤原 裕 氏

【講演2】「ダイボンド部における固液反応拡散接合の適用」

大阪大学大学院工学研究科 准教授 福本 信次 氏



『第2回 テーマ「プロセス」』

日時：平成27年11月24日（火）

場所：京都リサーチパーク イノベーションルーム

出席者：65名

【講演1】「パワーエレクトロニクス向け素子接合の課題と対応」

(株)日立製作所

【講演2】「パワーモジュールパッケージング技術の動向と課題」

三菱電機(株)



『第3回 テーマ「応用」』

日時：平成28年2月29日（月）

場所：京都リサーチパーク ルーム1

出席者：86名

【講演1】「車載向けパワーモジュールの現状と課題」

インフィニオンテクノロジーズジャパン(株)

【講演2】「パワーモジュール実装工法と高信頼性接合材料」

千住金属工業(株)



◆個別プロジェクト支援（事業化検討会、研究会 他）◆
各種ニーズへの対応策・新たな技術提案を 連携のパートナーとともに深堀する事業化検討をサポート

シーズ発信

◆新規プロジェクト創出企画～E2 Square～◆
新規ビジネスの創出を目指す、ニーズとシーズが出会う場を提供。製品メーカによる課題・ニーズの説明を実施。
[* E2 Square スキーム図 *](#)

Step1 E2 Square『技術課題・技術ニーズ説明会』
日時：平成27年年12月11日（金）
場所：京都リサーチパーク イノベーションルーム
出席者：77名
<第1部>「ロボット新戦略とNEDOの取組み」 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
ロボット・機械システム部 主査 安川 優 氏
<第2部>「パナソニックにおける介護ソリューションの取組み」 パナソニック(株) エコソリューションズ社
※説明会終了後、別会場にて交流会を開催

Step2 『有望シーズ選定』

Step3 E2 Square『技術プレゼンテーション会』
日時：平成28年2月22日
場所：京都リサーチパーク イノベーションルーム
Step2で選定を受けた企業が課題解決提案

◆ミッション団派遣（台湾）◆
・近畿経済産業局およびネットワーク企業によるミッション団が、台湾最大のハイテク産業拠点である新竹科学工業園区と台湾の中心である台北市を訪問。台湾のものづくり企業とのビジネス交流。
期間：10月28日～10月31日
訪問先：新竹科学工業園区（HSP）、工業技術研究院（ITRI）、台湾区電気電子同業公会（TEEMA）
<<旅程>>

日 程	内 容	場 所
10/28	移動（関空→台北→新竹） HSP管理局及びHSP園区内視察	新竹（HSP）
10/29	HSP入居企業視察（Etron、Epistar） マッチング商談会(計4社)	新竹（HSP）
10/30	ITRI視察、スピンアウト企業との商談 TEEMA訪問及びメンバー企業と交流	新竹（ITRI） 台北（TEEMA）
10/31	ラップアップミーティング（活動総括） 移動(台北→関空)	—

<<内容詳細>>
10月28日(水) --新竹科学工業園区（HSP）訪問--
台湾最大のハイテク産業集積地であるHSPを訪問。HSPミュージアムと世界的な半導体関連企業UMCやTSMCの工場が数多く立ち並ぶHSP園区内を見学し、日台連携の可能性についてHSP管理局と意見交換。



HSP管理局訪問



HSPミュージアム見学

平成27年度経済産業省委託「新分野進出支援事業（地域イノベーション創出促進事業（エレクトロニクス、エネルギーシステム産業創出事業（新技術ビジネス化促進事業））」

10月29日(木)

--企業見学；Etron社、Epistar社--

世界的なIC設計のファブレスメーカーであるEtron社と、世界最大規模のLEDチップ製造工場を誇るEpistar社を訪問し、関西地域のポテンシャルやネットワーク企業のオンリーワン技術やナンバーワン技術を紹介。マッチングに加え、関西地域のもづくり企業とのビジネスの可能性について意見交換。



Etron社



Etron社訪問



Epistar社訪問

--ビジネスミーティング@HSP--

近畿経済産業局による関西地域の紹介や、ファクトシート集を活用したネットワーク企業の技術紹介、参加企業による技術プレゼンテーション。合わせて、日台企業間のビジネスマッチングを実施。

【ビジネスミーティングの活動例】

- ・ネットワーク企業の1社である(株)サクラクレパスがオンリーワン技術「プラズマインジケータTM『PLAZMARK®』」を紹介。台湾ものづくり企業4社と個別マッチングを実施。
- ・当日参加の台湾企業より、ネットワーク企業への商談引き合いが2件あり、KRPからネットワーク企業へ繋いだ。

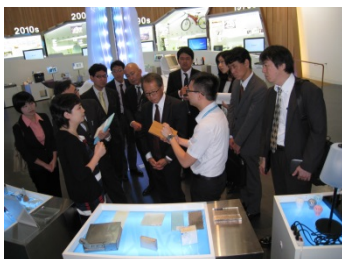


HSPにてビジネスミーティング：
サクラクレパスのプレゼンテーションの様子

10月30日（金）--工業技術研究院（ITRI）訪問、台湾区電気電子同業公会（TEEMA）訪問--

午前中は、ITRIを訪問。世界的な半導体メーカーTSMCがITRIからスピンアウトした経緯など、台湾のエレクトロニクス産業の歴史について説明があった。ショールーム見学後、スピンアウト企業1社と個別マッチングを実施した。

午後は台北市に移動。TEEMAを訪問し、関西地域のポテンシャルやネットワーク企業の技術についてPR。関西地域のもづくり企業とのマッチングの可能性や仕組みづくりに関して意見交換をし、その後、現地企業との交流会にも参加した。



ITRI訪問



TEEMA訪問

10月31日（土）

ラップアップミーティングにて、活動内容の確認、課題の抽出と対策についての検討、帰国後のアクションプランや方向性について総括を行った後、帰国。

◆企業事例集◆

ネオエレクトロニクスデザインの次代へ - 近畿エレクトロニクス関連シーズ・企業事例集Ⅱ - 発行

[（詳細はこちら）](#)